

LiquidJet™ 冷板

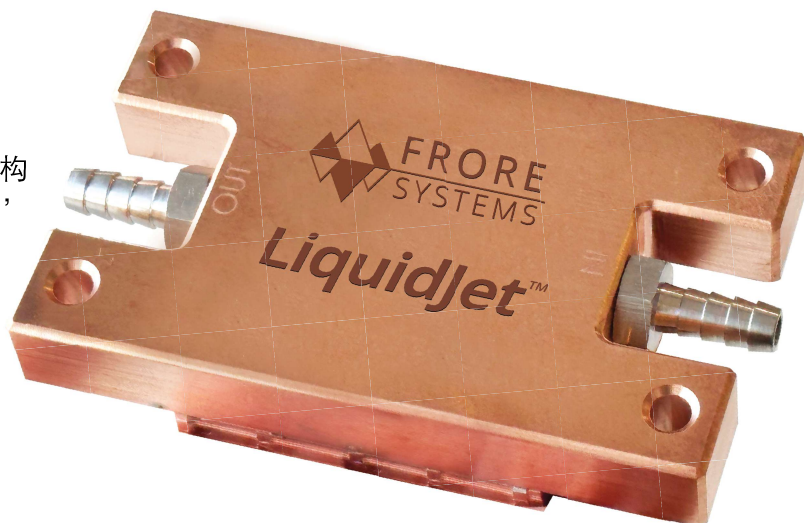


更低温的 GPU，
更高的 AI 令牌每秒处理量，
更低的总拥有成本（TCO）

我们推出突破性的 LiquidJet 冷板，其搭载多级散热架构 3D 混合单元，以及创新型 3D 短回路射流通道微结构，可适配任意 GPU 功耗分布。

在英伟达 Blackwell Ultra 平台上，LiquidJet 可实现：

- GPU 温度降低 7.7°C
- 散热效能（kW/lpm）提升 75%
- 重量减轻 50%
- 轻松即插即用升级

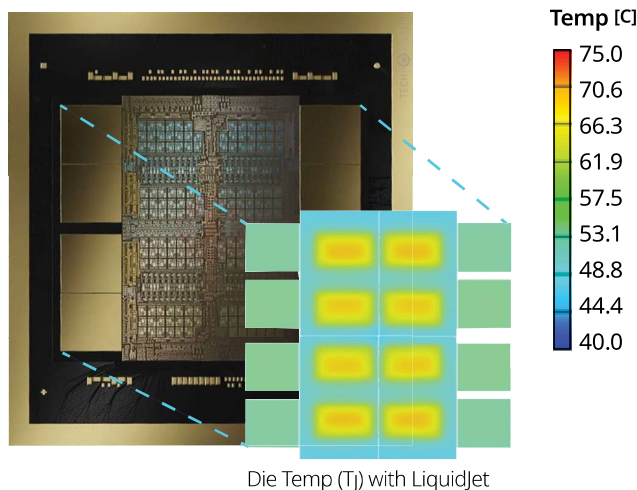


Blackwell Ultra 平台性能对比

	LiquidJet 冷板	顶级铣削冷板
GPU 功率	1400 W	1400 W
最高 GPU 核心温度 (@ 2.1 lpm 流量下)	67.6°C	75.3°C
PG25 流量 (@ 核心温度相同时)	1.2 lpm	2.1 lpm
冷板重量	260 g	550 g

注：最大通道宽度 0.1mm | 入口水温 40°C | TJM PTM7950

Blackwell Ultra

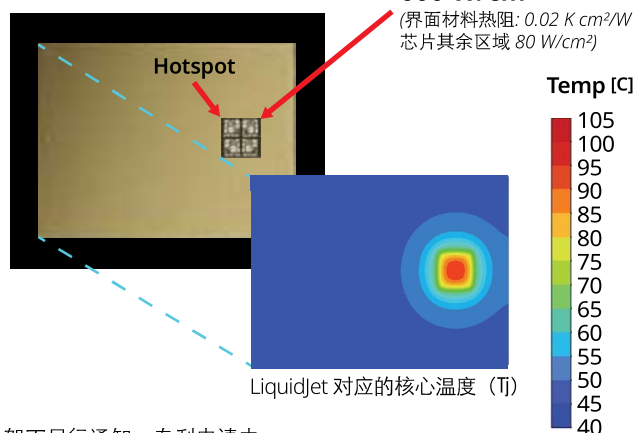


LiquidJet 的热点散热能力

LiquidJet 创新的多级架构可将全部流量先集中用于优先冷却 GPU 热点区域，再冷却其他区域。

在入口水温 40° C 时，LiquidJet 可实现高达 600 W/cm² 的热点散热能力，远超下一代 GPU（包括 Rubin、Rubin Ultra、Feynman 及定制 ASIC）的散热需求。

GPU with 热点



LiquidJet™ 冷板

可定制化散热方案

传统冷板依赖铣削微通道的 2D 流道，难以适配新型芯片布局及日益多样化的高功率密度需求。
Frore Systems 另辟蹊径，将半导体制造工艺应用于金属晶圆，打造出多级冷却架构、3D 混合单元结构以及创新的 3D 短回路射流通道微结构。这些设计能够精准匹配现代 GPU 的功耗分布。

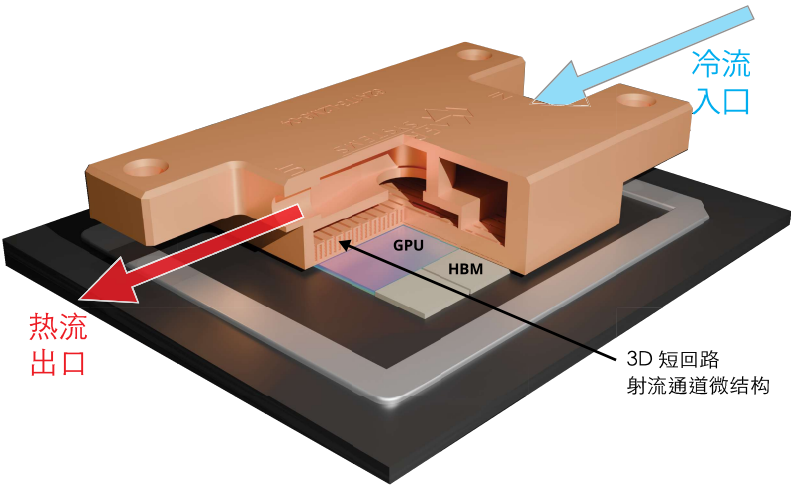
可定制化适配您 GPU 的精准功率密度

LiquidJet 是一款能够随芯片进化而进化的冷板。

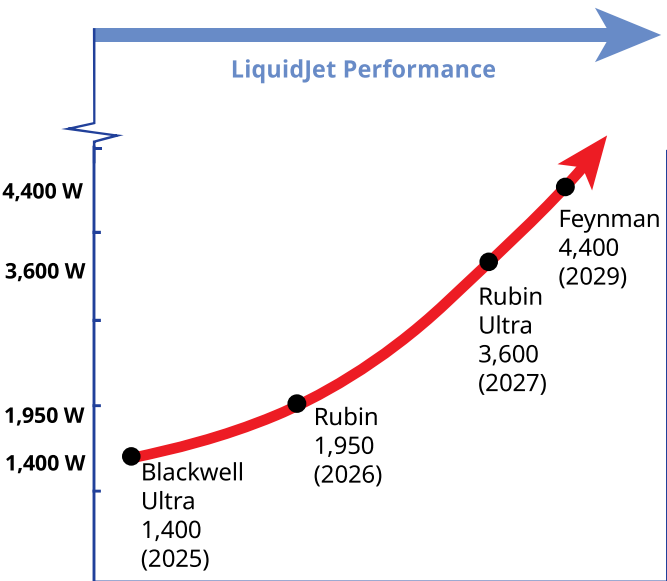
通过这些技术进步，数据中心可以实现：

- 更低的 GPU 运行温度
- 更高的 AI 每秒令牌 (Tokens) 产出
- 更低的总体拥有成本 (TCO)
- 提升电源使用效率 (PUE)
- 更高的系统可靠性

LiquidJet —— 重新定义 AI 数据中心液冷技术。



面向未来：支持 NVIDIA Feynman GPU 及后续产品



扫码了解
更多详情